

## Presseinformation

### **Innovation is in our DNA – Viscom auf der productronica 2019**

*Hannover, 9. Oktober 2019* – Als einer der Technologieführer für optische und röntgentechnische Inspektionssysteme in der Elektronikfertigung stellt die Viscom AG auf der diesjährigen Weltleitmesse productronica 2019, vom 12. bis 15. November in München, gleich mehrere Neuentwicklungen vor. Im Fokus stehen Smart-Factory-Lösungen, die die Taktzeit minimieren, Prozesse effizienter gestalten und Fehler vermeiden – kurzum für mehr Sicherheit in der SMT-Fertigung sorgen. Dazu braucht es Innovationen wie z. B. die AI-unterstützte Verifikation, extrem hohe Inspektionsgeschwindigkeiten und eine lückenlos hochpräzise Fehlerinspektion von anspruchsvollsten Baugruppen. Auch Trendentwicklungen wie die E-Mobilität, neue Energien, LEDs und Leistungselektronik erfordern neue Inspektionslösungen – z. B. die innovative Inline-Röntgeninspektion mit integriertem Handling von Werkstückträgern von Viscom.

Im Bereich Röntgentechnologie hat Viscom jetzt sein breites Systemangebot für Offline- und Inline-Röntgen um eine weitere Innovation erweitert: Speziell entwickelt für anspruchsvollste Leistungselektronik und Komponenten für E-Mobilität und erneuerbare Energien ermöglicht das neue Inline-System **X8068 SL** die vollautomatische Prüfung auch von massiven und großen Prüfobjekten. Das Inline-Röntgensystem überzeugt dabei mit einem integrierten Transportkonzept mit Werkstückträgern und prüft schnell und präzise die Anbindung von Leistungshalbleitern und andere qualitätsrelevante Bereiche wie etwa Flächenlötungen. Viscom bietet eine maßgeschneiderte Abstimmung auf die Anforderungen der Kunden, um eine nahtlose Integration in die Linie zu realisieren – für eine zukunftssichere Investition.

Einen neuen Milestone in der schnellen und hochpräzisen Inline-Röntgenprüfung hat Viscom bereits mit dem System **X7056-II** gesetzt, das international schon mehrfach für sein innovatives Maschinenkonzept ausgezeichnet worden ist. Mit schnellster vollständiger Inline-Inspektion und den überragenden Vorteilen einer kombinierten 3D-AXI- und 3D-AOI-Qualitätsprüfung in einer Maschine, etabliert sich diese Röntgenlösung – sowohl als Kombi-System als auch als reine Röntgenmaschine – in modernsten SMT-Linien weltweit. Die X7056-II kann in der High-Volume-Produktion eine präzise Inspektion von verdeckten Lötstellen und Bauteilen sicherstellen. Die 3D-Rückrechnung der X7056-II basiert auf der planaren Computertomografie, die unsichtbare Fehler in klaren Schnittbildern deutlich sichtbar macht. Auf der productronica kann man das System am Messestand von Viscom live unter der intuitiven Bedienoberfläche vVision erleben, die eine besonders schnelle Prüfplanerstellung und -optimierung gewährleistet.

Die langjährige Entwicklungskompetenz von Viscom im Bereich 3D-AOI hat eine ganz besondere Neuentwicklung hervorgebracht: Das neue System **S3016 ultra, ein Bottom-Up-System, das erstmalig in 3D** eine herausragende und durchsatzstarke 3D Inspektion von unten für THT-Lötstellen und Pressfit-Verbindungen gewährleistet. Darüber hinaus bietet Viscom jetzt eine einzigartige Vielfalt an Sensortechnologien für das neue System **S3088 DT**, das für einen besonders wirtschaftlichen Doppelspurbetrieb in der Großserienfertigung konzipiert ist. Die Systemkonfiguration gestaltet sich besonders flexibel, um verschiedenste Prüfungen vollautomatisch durchzuführen: Die Varianten reichen von 3D-AOI und 3D-SPI über CCI bis hin zu UFI – und damit für ein Maximum an Prüfqualität und Durchsatz bei der Bestück-, Lötstellen-, Lotpasten-, Lackschicht- und Underfillkontrolle.

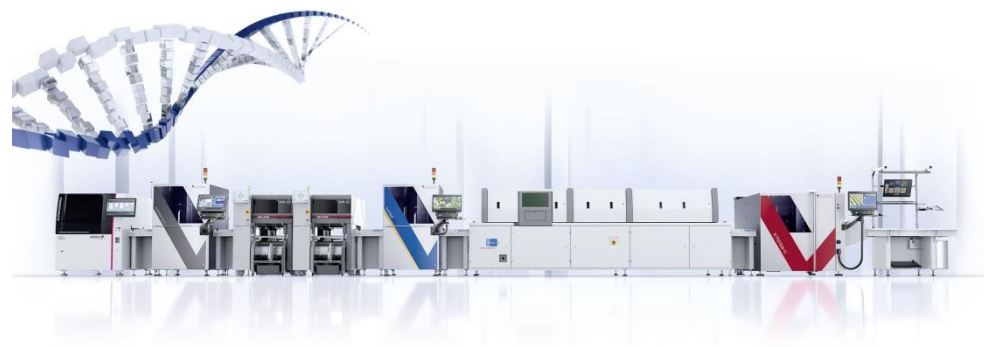
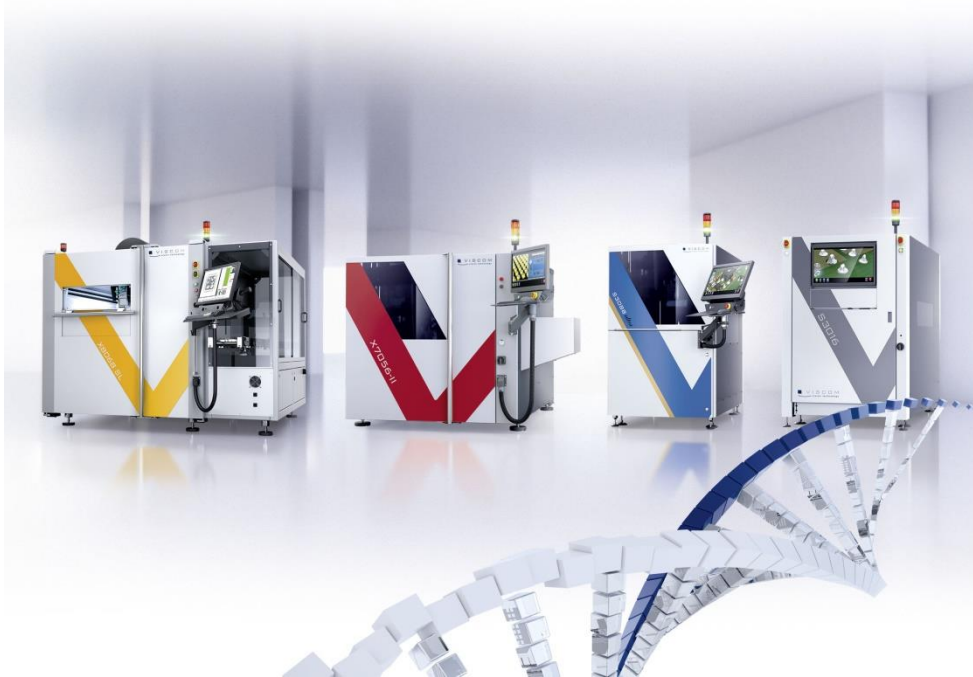
Nicht verpassen sollten Besucherinnen und Besucher der productronica die **3D-AOI-Arena** in Halle A2, in der verschiedenste Hersteller ihre 3D-AOI-

Systeme im Vergleich vorstellen. Sie können dort das Premium-System **S3088 ultra gold** von Viscom live erleben, das zuverlässigste 3D-AOI-Prüfergebnisse mit bester, nahezu abschattungsfreier Bildqualität und realistischen 360-Grad-Ansichten liefert.

Für höchste Anforderungen der **Smart Factory** bietet Viscom offene Schnittstellen und Inhouse-Softwarelösungen, um die fortschrittlichen Inspektionssysteme perfekt in Industrie-4.0-Prozesslinien zu integrieren. Gerade im Hinblick auf Smart Maintenance und Traceability bietet Viscom intelligente Konzepte, die Fehler von vornherein vermeiden, die Wirtschaftlichkeit der Fertigung entscheidend erhöhen und die Leistung der Inspektionssysteme auf Spitzenniveau steigern. Für eine optimierte und zuverlässigste Verifikation präsentiert Viscom zudem ein zukunftsweisendes Softwarekonzept mit künstlicher Intelligenz.

Viscom stellt in **Halle A2, Stand-Nr. 177** sein innovatives und umfassendes Spektrum an Inspektionslösungen in den Bereichen 3D-SPI, 3D-AOI, 3D-AXI, MXI, CCI und Bond vor.

**Bilder**



### **Über Viscom**

Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige Inspektionssysteme. Das Spektrum umfasst die komplette Bandbreite der optischen Inspektion und Röntgenprüfung. Im Bereich der Baugruppeninspektion für die Elektronikfertigung gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern weltweit. Die Systeme von Viscom lassen sich kundenspezifisch konfigurieren und miteinander vernetzen. Hauptsitz und Fertigungsstandort des Unternehmens ist Hannover. Viscom verfügt über ein großes internationales Netz aus Niederlassungen, Applikationszentren, Servicestützpunkten und Repräsentanten. Gegründet 1984 notiert Viscom seit 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE0007846867). Weitere Informationen: [www.viscom.com](http://www.viscom.com).